

# 2025年3月期 第2四半期 決算説明資料

---

マクニカホールディングス株式会社

2024年10月28日

# AGENDA

## 01. 実績報告

- ① 2024年度 上期 業績ハイライト
- ② 2024年度 上期 実績（連結）

## 02. 中期経営計画（2022年～2024年度）

- ① 全社
- ② 半導体事業
- ③ ネットワーク事業
- ④ CPSソリューション事業
- ⑤ 経営基盤強化

## 03. Appendix

- ① 四半期推移

※ 本プレゼンテーションでは、「集積回路及び電子デバイスその他事業」を半導体事業としています。報告セグメントにおいては、CPSソリューション事業の数字は、半導体事業、ネットワーク事業に含まれており、数字が重複します。

# 01. 実績報告

---

## ① 2024年度 上期 業績ハイライト

## 2024年度 上期 業績ハイライト

単位：億円	第2四半期				4-9月累積				FY24通期	
	実績	前年同期比		前四半期比		実績	前年同期比		計画 (修正後)	進捗率
売上高	2,626	▲58	▲2%	+63	+3%	5,190	▲280	▲5%	10,400	50%
半導体事業	2,268	▲156	▲6%	+81	+4%	4,455	▲470	▲10%	8,925	50%
ネットワーク事業	358	+98	+38%	▲18	▲5%	735	+190	+35%	1,475	50%
営業利益	103	▲70	▲41%	▲17	▲14%	224	▲156	▲41%	445	50%
半導体事業	76	▲86	▲53%	▲10	▲12%	163	▲182	▲53%	323	51%
ネットワーク事業	27	+16	+143%	▲7	▲20%	61	+26	+76%	122	50%
親会社株主に帰属する純利益	72	▲51	▲41%	▲8	▲10%	152	▲106	▲41%	300	51%
営業キャッシュフロー						185	▲42	▲18%		
平均為替レート (¥/USD)	154.13円					153.64円			145円 (FY24計画)	

## ● 上期は半導体は軟調、ネットワークは好調を継続

半導体事業は、注力市場である産業機器向けが、中国市場での最終製品の需要低迷などを受け▲445億円/▲35%（売上高/前年同期比）となり、売上高は計画を上回ったものの、利益は未達

ネットワーク事業は、エンドポイントセキュリティ関連製品が伸長し、国内・海外共に好調に推移

## ● 下期に見込んでいた半導体市場の回復は来年度に後ずれ

半導体事業は、産業機器市場の低迷が長期化することが見込まれ、回復は来年度に後ずれ

ネットワーク事業は、引き続き国内・海外共好調に推移する見込み

## ● 2024年度通期見込みを下方修正

半導体事業の状況を鑑み、売上高/利益を下方修正する一方、自己株式取得30億円を決定

## 配当の状況 (1株当たり)

	中間	期末	年間	配当性向
2023年度	26.66円	40円	66.66円	25%
2024年度	35円	35円 ※1	70円 ※1	42% ※1

※1 予想

2024年10月1日を効力発生日として、普通株式1株につき3株の株式分割実施。分割日以前についても、株式分割が行われたと仮定しての数値を記載。

(株)グローセルは2024年3月末B/S連結、2024年4月よりP/L連結 (半導体事業)

# 01. 実績報告

---

## ② 2024年度 上期 実績 (連結)

## セグメント別：売上高

5,190億円 前年同期比▲5.1%

(億円)

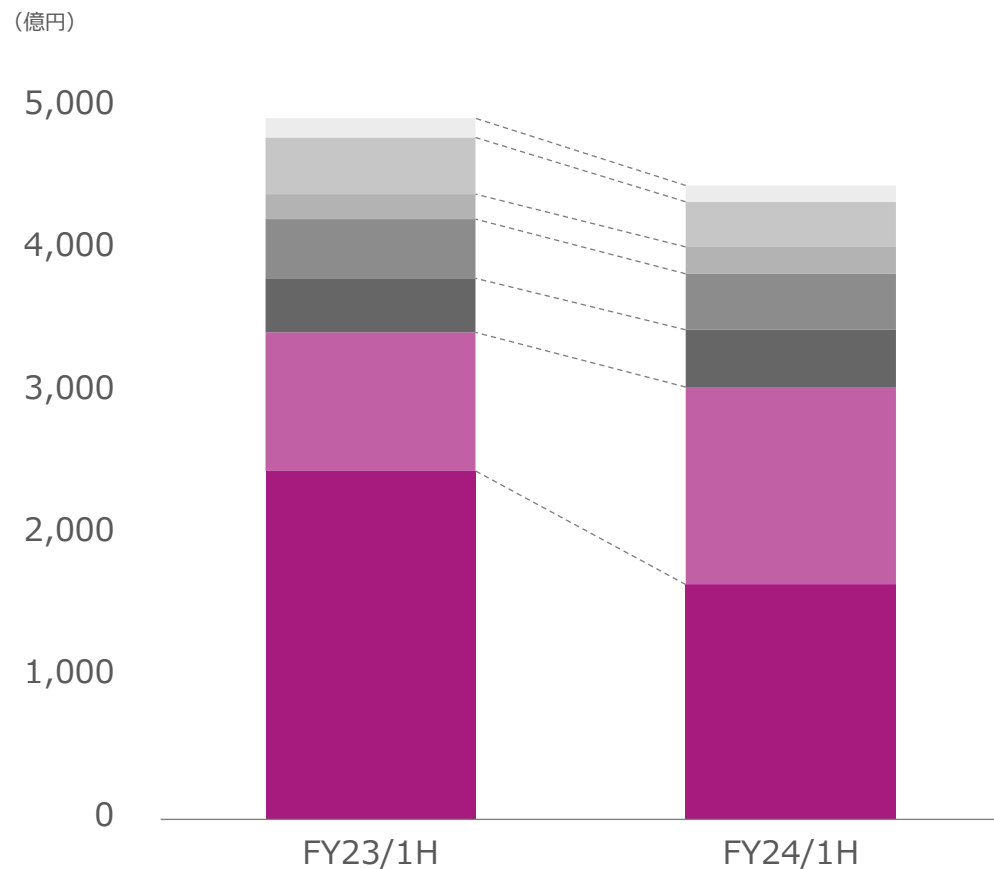


前年同期比▲5.1%

	FY23/1H		FY24/1H		前年同期比	
	実績	構成比	実績	構成比	増減額	増減率
(単位：億円)						
半導体	4,926	90%	4,455	86%	▲470	▲10%
ネットワーク	544	10%	735	14%	+190	+35%
<b>合計</b>	<b>5,470</b>	<b>100%</b>	<b>5,190</b>	<b>100%</b>	<b>▲280</b>	<b>▲5.1%</b>

## 半導体事業 (用途別) : 売上高

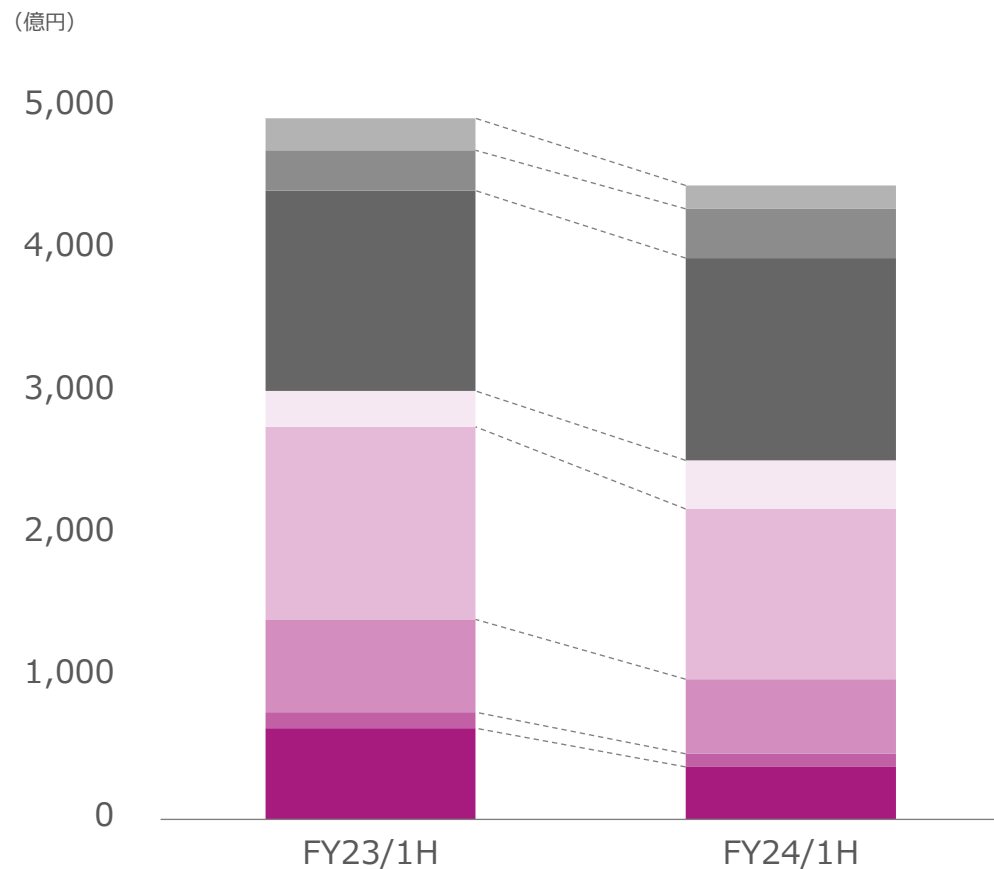
4,455億円 前年同期比▲9.6%



(単位：億円)	FY23/1H		FY24/1H		前年同期比	
	実績	構成比	実績	構成比	増減額	増減率
通信端末	134	3%	115	3%	▲19	▲14%
通信インフラ	398	8%	317	7%	▲81	▲20%
OA・周辺機器	176	3%	189	4%	+13	+7%
コンピュータ	416	8%	394	8%	▲22	▲5%
民生機器	380	8%	403	9%	+23	+6%
車載	973	20%	1,386	31%	+413	+42%
産業機器	2,449	50%	1,651	37%	▲798	▲33%
<b>合計</b>	<b>4,926</b>	<b>100%</b>	<b>4,455</b>	<b>100%</b>	<b>▲470</b>	<b>▲9.6%</b>

## 半導体事業 (品目別) : 売上高

4,455億円 前年同期比▲9.6%



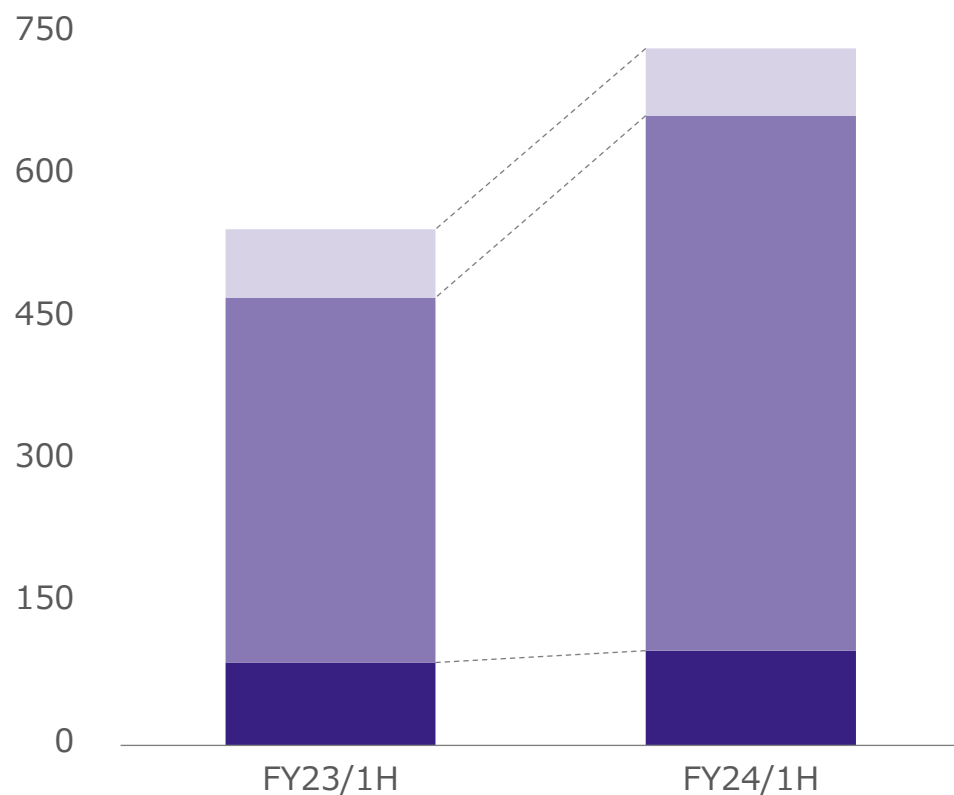
(単位: 億円)	FY23/1H		FY24/1H		前年同期比	
	実績	構成比	実績	構成比	増減額	増減率
その他	224	5%	165	4%	▲59	▲26%
電子デバイス	282	6%	345	8%	+63	+23%
その他標準IC	1,408	29%	1,422	32%	+14	+1%
メモリー	252	5%	342	7%	+90	+36%
アナログ	1,354	27%	1,194	27%	▲159	▲12%
ASSP	652	13%	524	12%	▲128	▲20%
ASIC	112	2%	93	2%	▲19	▲17%
PLD	642	13%	368	8%	▲274	▲43%
<b>合計</b>	<b>4,926</b>	<b>100%</b>	<b>4,455</b>	<b>100%</b>	<b>▲470</b>	<b>▲9.6%</b>



## ネットワーク事業 (品目別) : 売上高

735億円 前年同期比+35.0%

(億円)



(単位: 億円)	FY23/1H		FY24/1H		前年同期比	
	実績	構成比	実績	構成比	増減額	増減率
ハードウェア	72	13%	71	10%	▲1	▲2%
ソフトウェア	385	71%	564	77%	+179	+47%
サービス	87	16%	100	13%	+13	+15%
<b>合計</b>	<b>544</b>	<b>100%</b>	<b>735</b>	<b>100%</b>	<b>+190</b>	<b>+35.0%</b>

## 02. 中期経営計画 (2022~2024年度)

---

### ① 全社

## 中期経営計画（2022～2024年度）の修正

	2024年度 経営数値目標 (2025年3月期)		
	2022年5月9日公表	2024年5月7日公表	今回修正
連結売上高	9,700 億円以上	1兆1,000 億円	<b>1兆400 億円</b>
連結営業利益	480 億円以上	640 億円	<b>445 億円</b>
連結営業利益率	5.0 %以上	5.8 %	<b>4.3 %</b>
連結当期純利益	300 億円以上	420 億円	<b>300 億円</b>
連結ROE ※1	15.0 %以上	15.0 %以上	<b>15.0 %以上</b>
運転資本回転率 ※2	3.8 以上	3.8 以上	<b>3.8 以上</b>

※1 連結 ROE = 連結親会社に帰属する当期純利益 ÷ 連結自己資本(純資産から非支配株主持分を除いたもの、期末時点)

※2 運転資本回転率 = 年間売上高 ÷ 運転資本(売上債権 + 棚卸資産 - 仕入債務、期末時点)

## 02. 中期経営計画 (2022~2024年度)

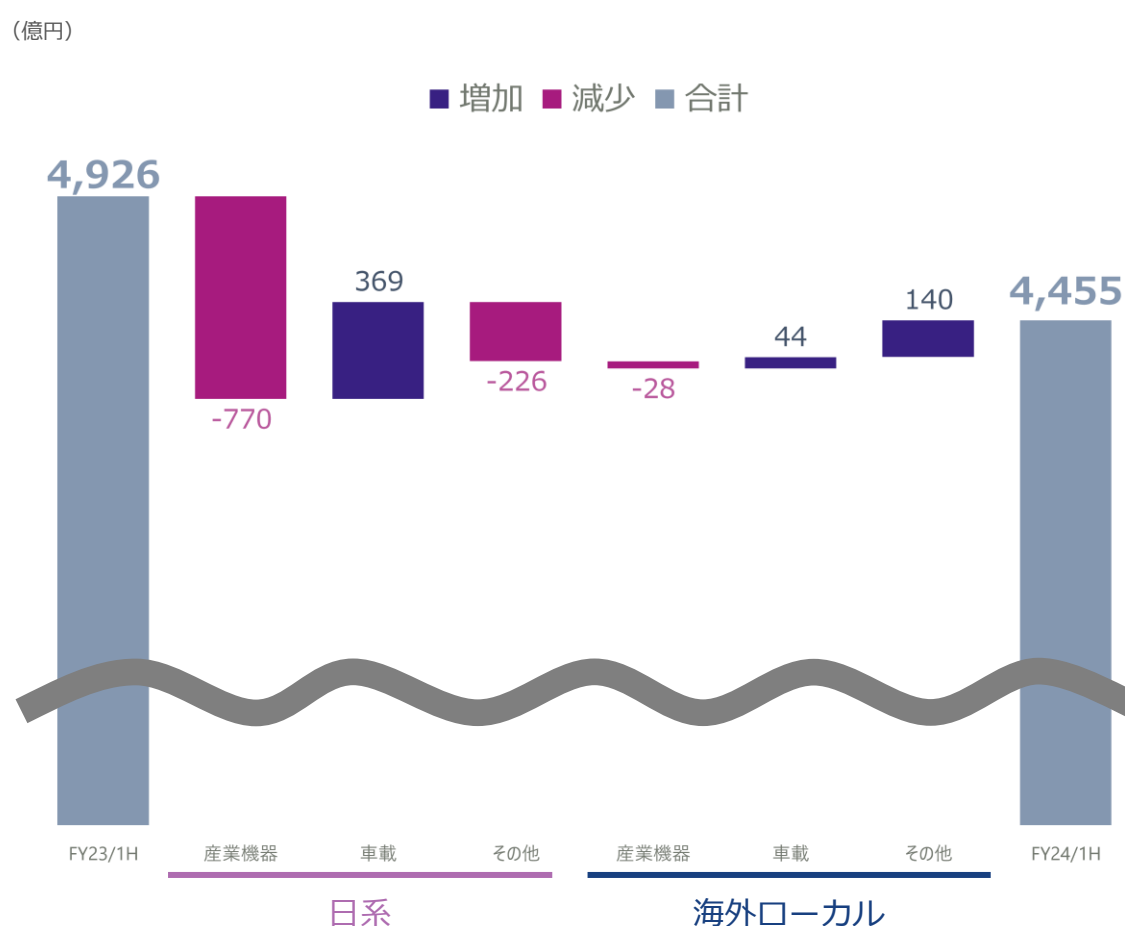
---

### ② 半導体事業

## 成長要因

## 前年同期比470億円減（▲10%） 車載市場は成長するも、産業機器市場が低迷

(億円)



## 日系企業向け

- 産業機器：中国市場停滞や在庫調整の影響にて幅広い分野で減少
- 車載：高性能化等による増加に加え、グローバル連結が寄与
- その他：在庫調整と前年の大型案件の影響により減少

## 海外ローカル企業向け

- 産業機器：中国市場停滞の影響を受け減少
- 車載：EV化により需要の増加
- その他：AIサーバー向けに需要が増加

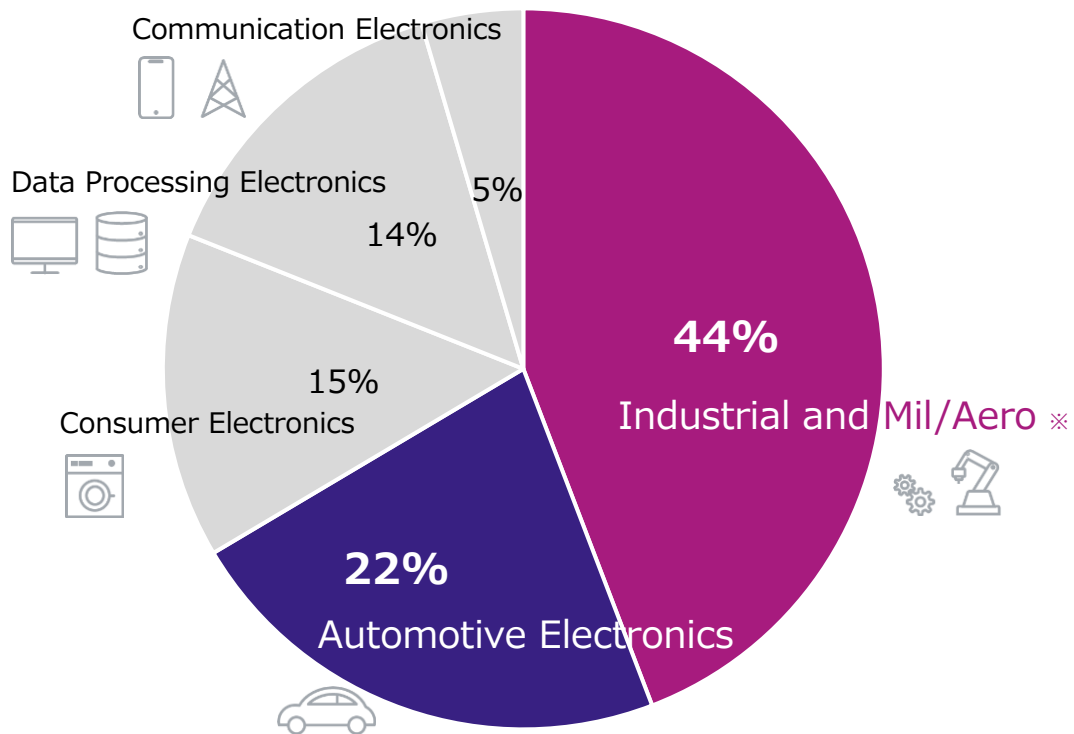
## 全体への影響

- 円安による為替影響
- 商圏拡大

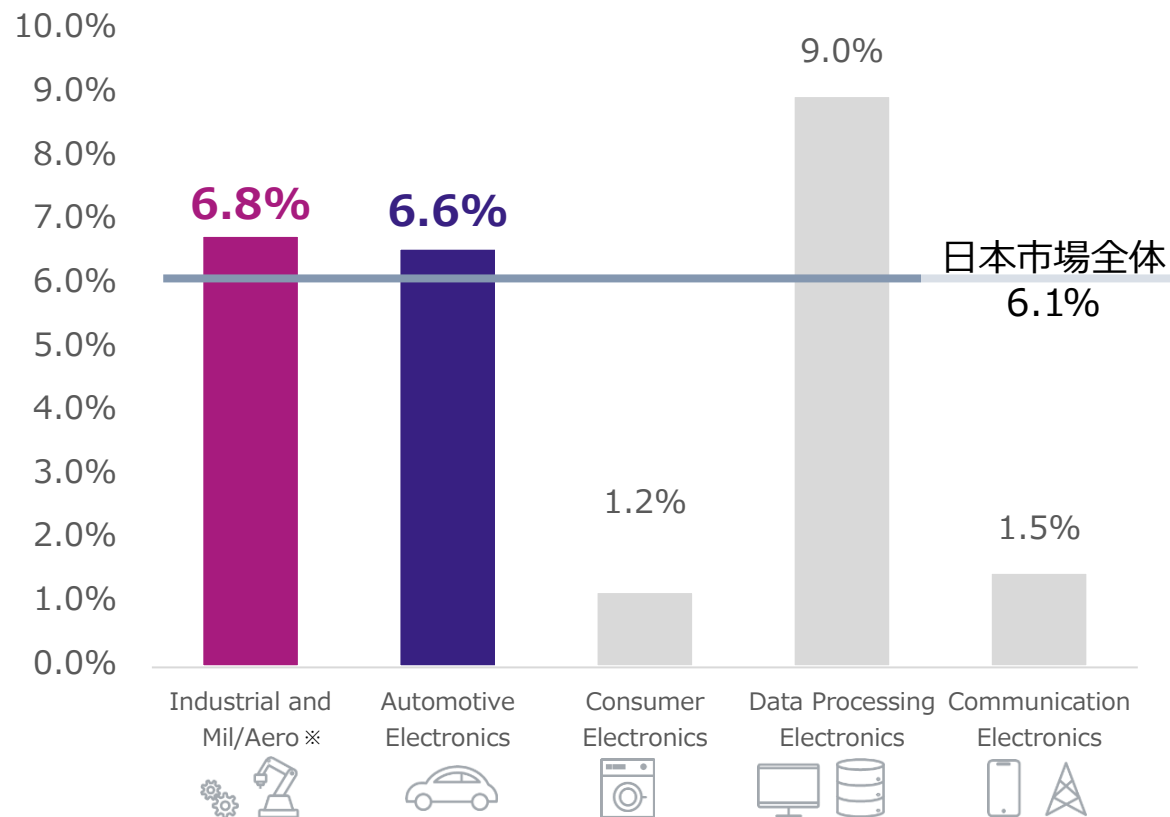
## 国内戦略市場（産業機器、車載市場）の状況

### 産業機器、車載市場が国内半導体市場をけん引

国内半導体市場 CY23の構成比



国内半導体市場 CY23-28のCAGR



Charts/graphics created by Macnica based on Gartner® research. Calculations performed by Macnica.

Source : Gartner®, Forecast: Semiconductors and Electronics, Worldwide, 2022-2028, 3Q24 Update, Masatsune Yamaji at, 24 September 2024, Revenue by semiconductor Device basis.

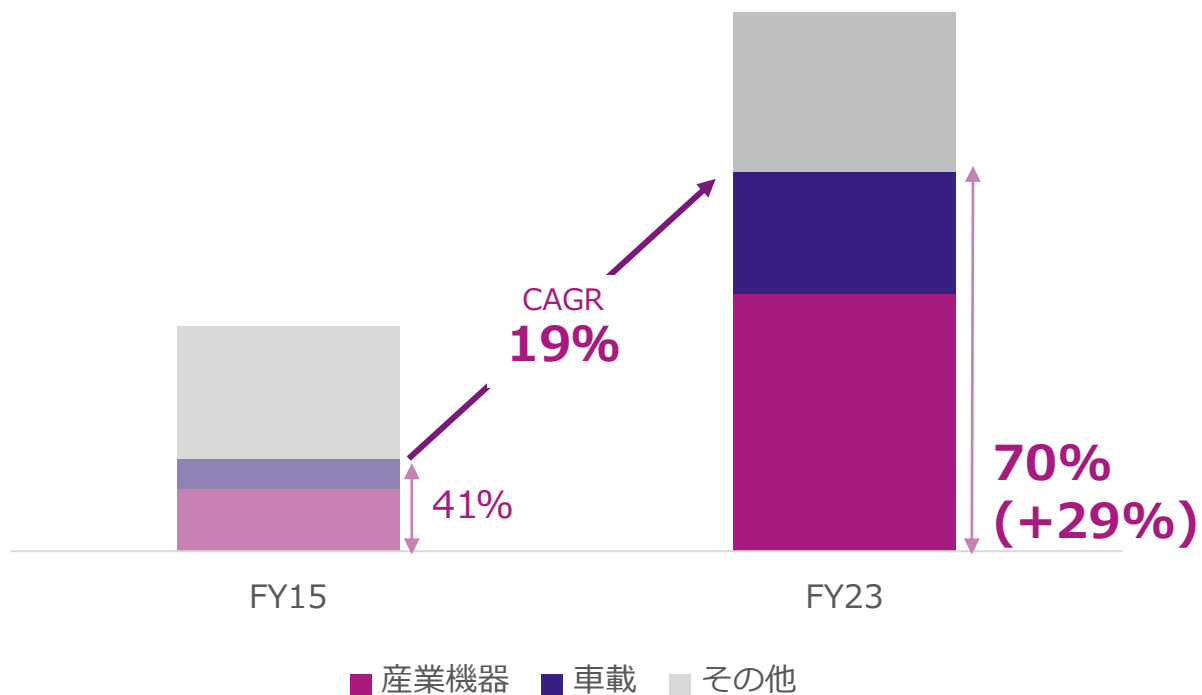
GARTNER is a registered trademark and service mark of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally and is used herein with permission. All rights reserved.

※ Industrial and Military/Civil Aerospace Electronics

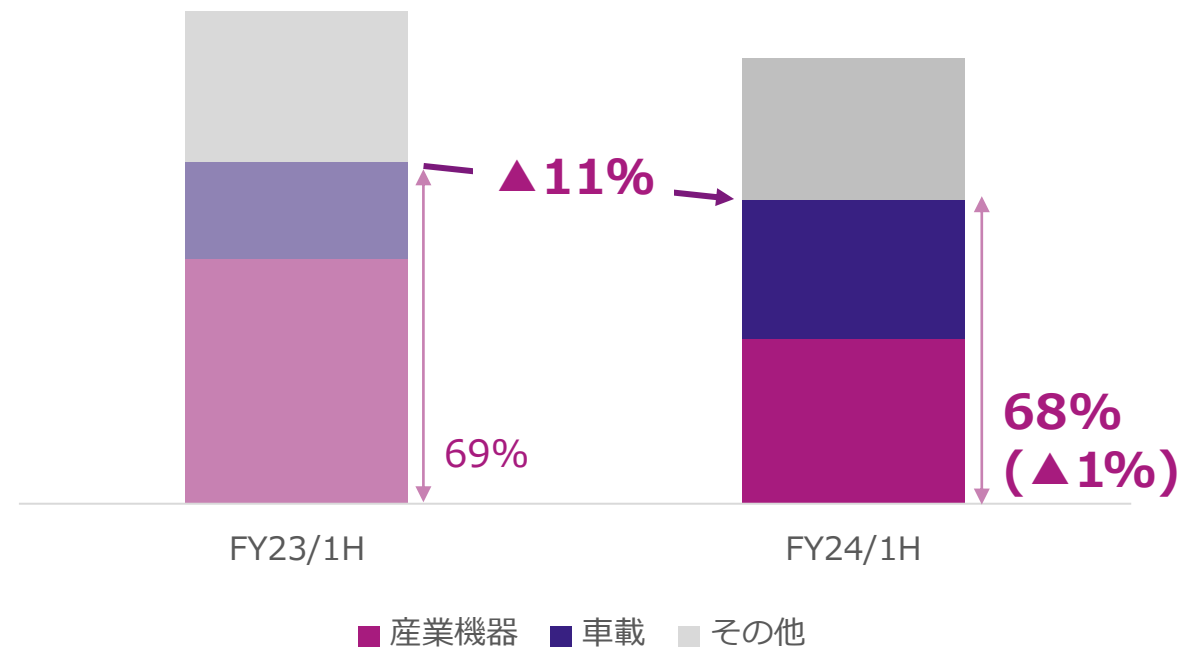
## 産業機器・車載市場への注力（当社売上）

## 注力市場である産機・車載市場で売上の約70%を占める

長期比較

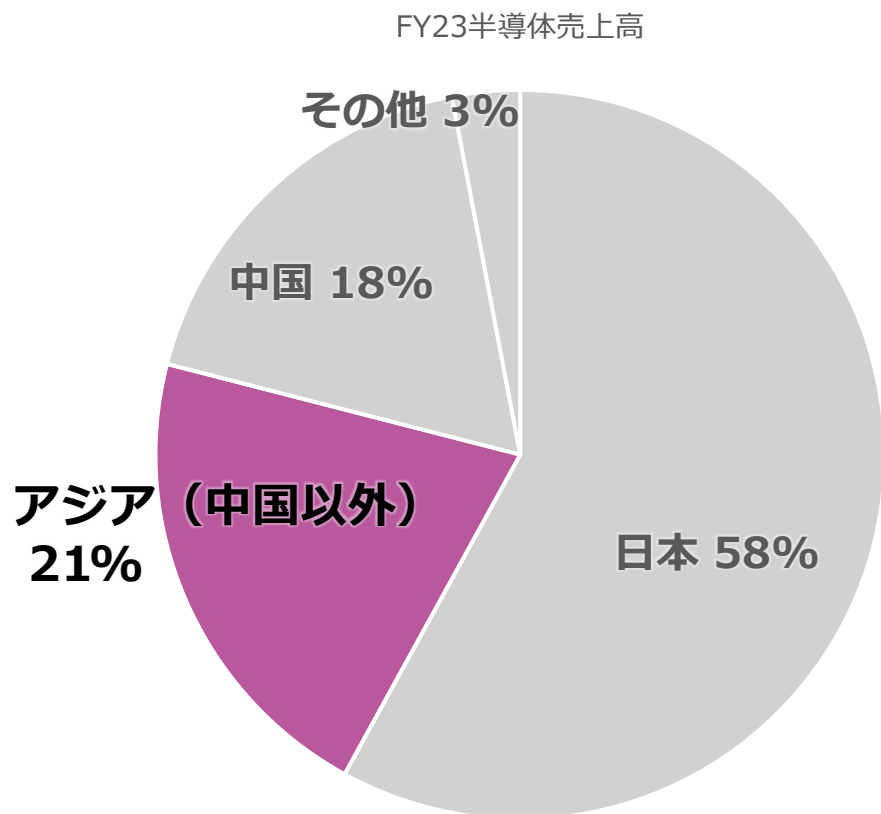


前年同期比



## アジアのビジネス強化

### 中国以外のアジアのビジネスを強化



#### 2024年9月 韓国Gillanix社から事業譲渡

アナログ系の事業を買収

主要顧客は車載、産機、通信

来年度年間140億円前後の連結売上相当



## 02. 中期経営計画 (2022~2024年度)

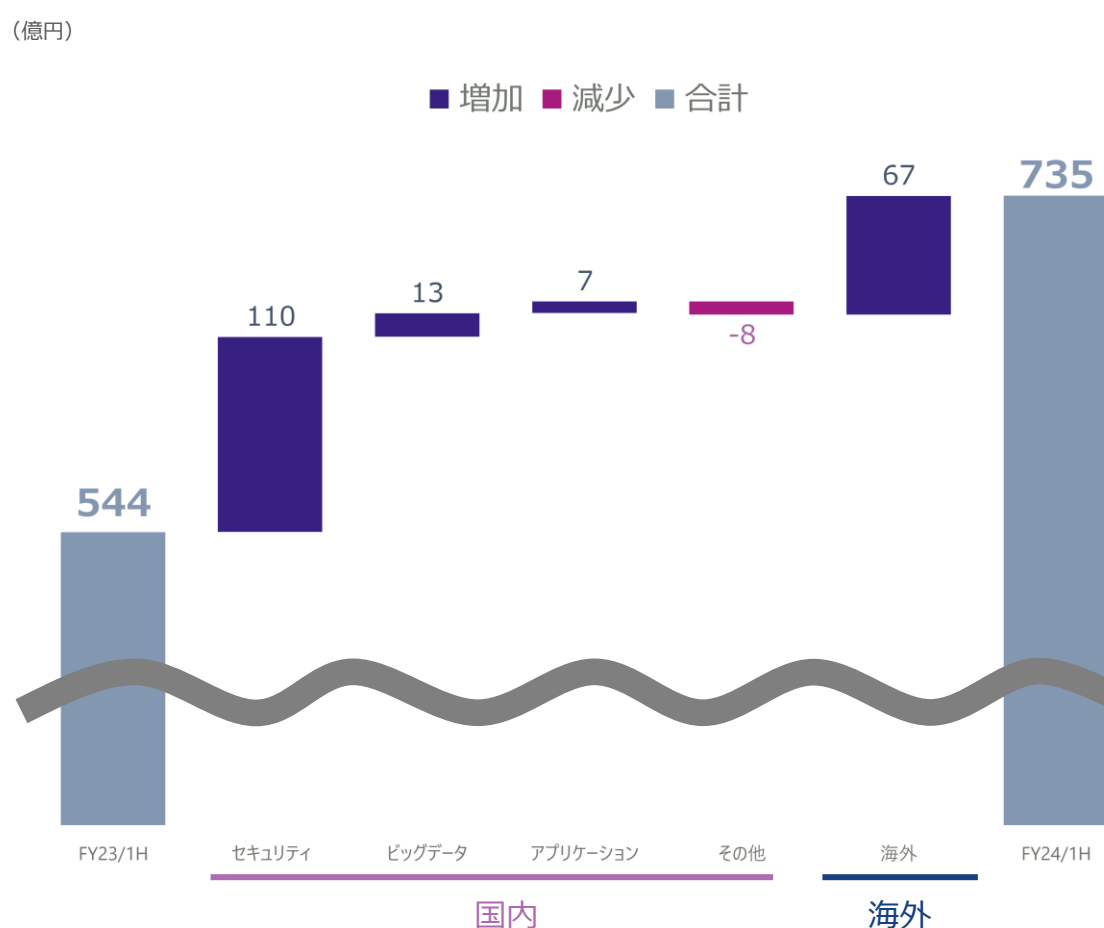
---

### ③ ネットワーク事業

## 成長要因

## 前年同期比190億円増（+35%）、全てのフォーカスエリアで成長

(億円)



## 国内 前年同期比123億円増（+34%）

- ・セキュリティ（+46%）  
エンドポイント、クラウドセキュリティ、セキュリティマネジメントを中心に伸長
- ・ビッグデータ（+29%）  
データ分析基盤、自社サービスを中心に伸長
- ・アプリケーション（+16%）  
クラウドアプリケーションを中心に伸長

## 海外 前年同期比67億円増（+37%）

シンガポール、マレーシア、オーストラリア、フィリピン、インドネシアを中心に伸長

## セキュリティビジネスの成長戦略

### 全てのフォーカス市場で成長

(当社売上は前年同期比)

#### ① サイバーセキュリティツール市場 SAM内シェアの拡大

**+40%** エンドポイントセキュリティが順調に成長。

#### ② サイバーセキュリティツール市場 SAMの拡大

**+304%** クラウド活用時のセキュリティ対策が順調に成長。

#### ③ サイバーセキュリティサービスの強化

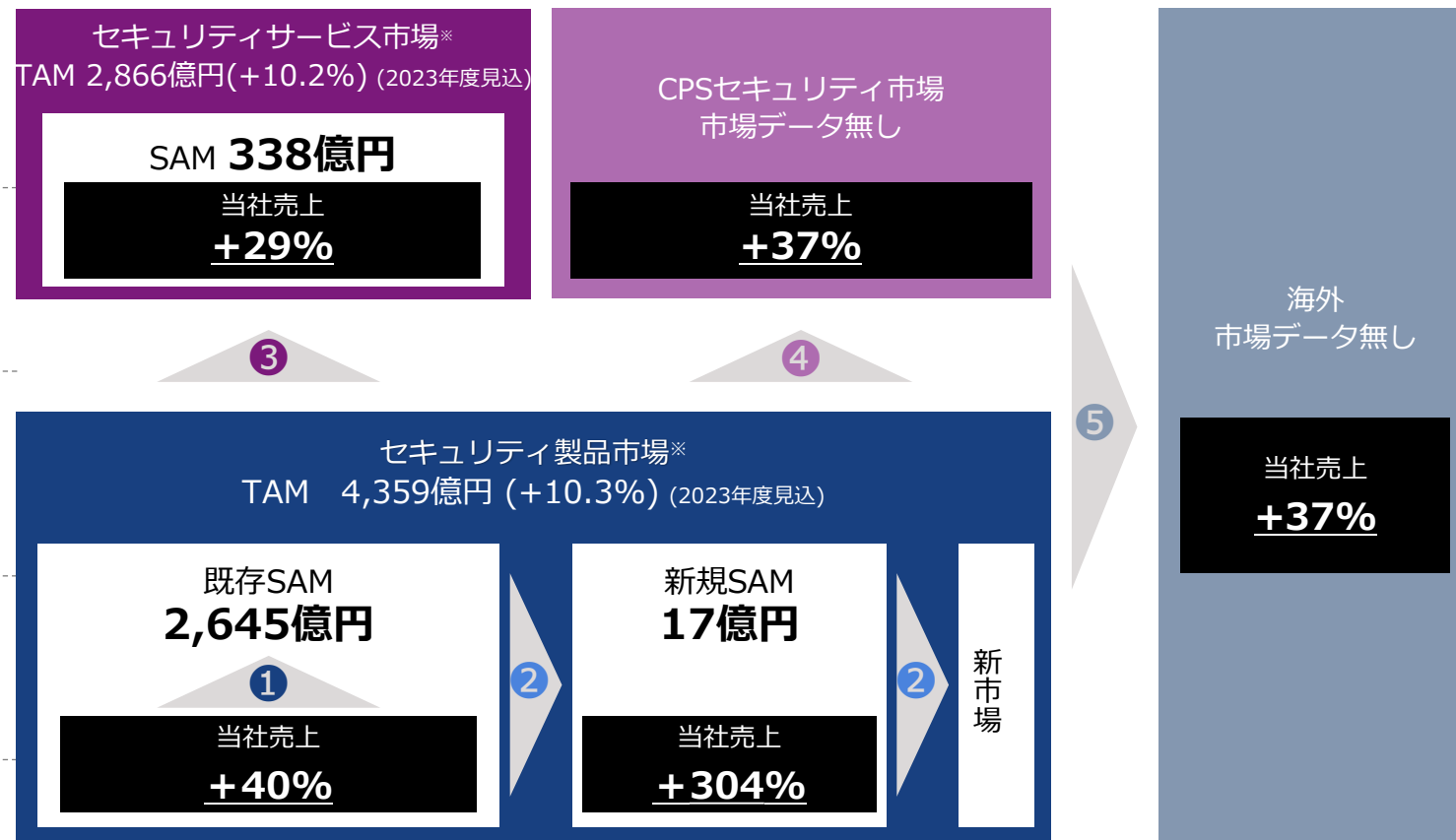
**+29%** ASM、統合監視サービスの受注が増加。  
ASM：VPN機器等の脆弱性特定手法を開発・実装し、特許出願。

#### ④ CPSセキュリティ事業化を推進

**+37%** IoT、OTのデバイス管理製品に加え、独自アセスメントサービスが成長。

#### ⑤ 海外展開の強化

**+37%** 全ての国で伸長。



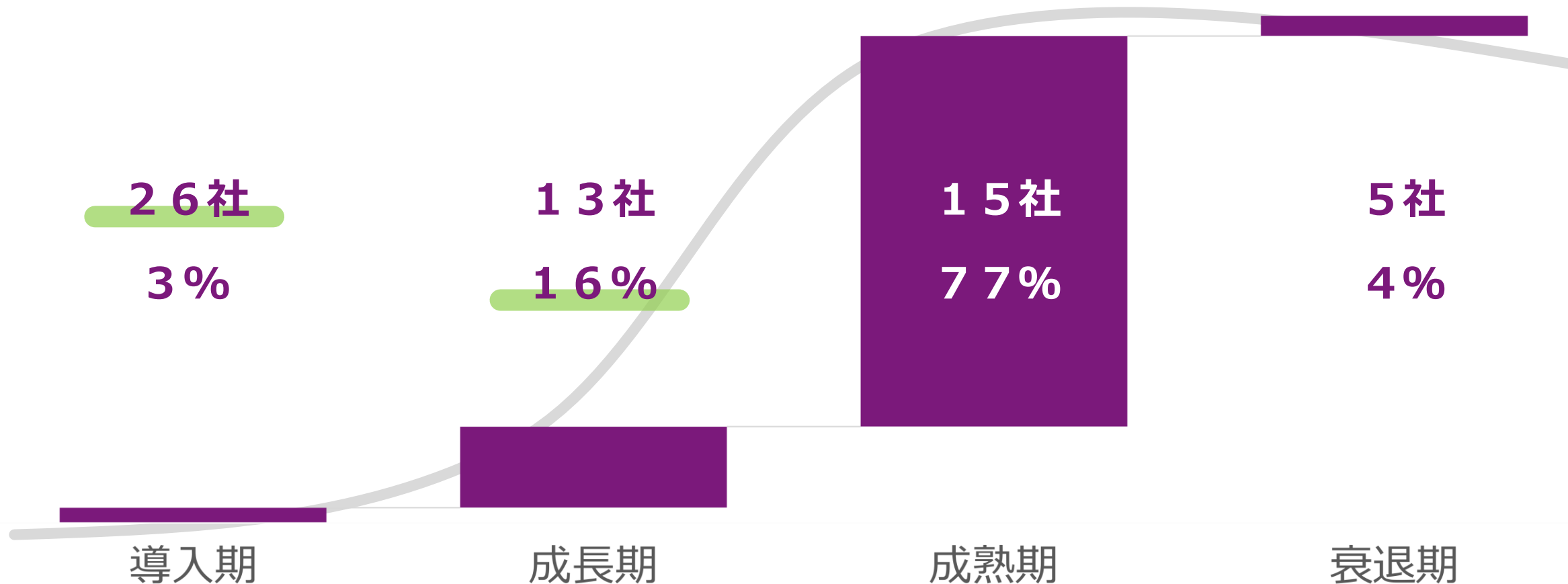
※ 「富士キメラ総研『2023ネットワークセキュリティビジネス調査総覧』〈セキュリティサービス市場〉、〈セキュリティ製品市場〉について」より (SAMは当社算出)

## 国内ネットワーク事業

導入期商材のソーシング、成長期のラインの立ち上げが順調

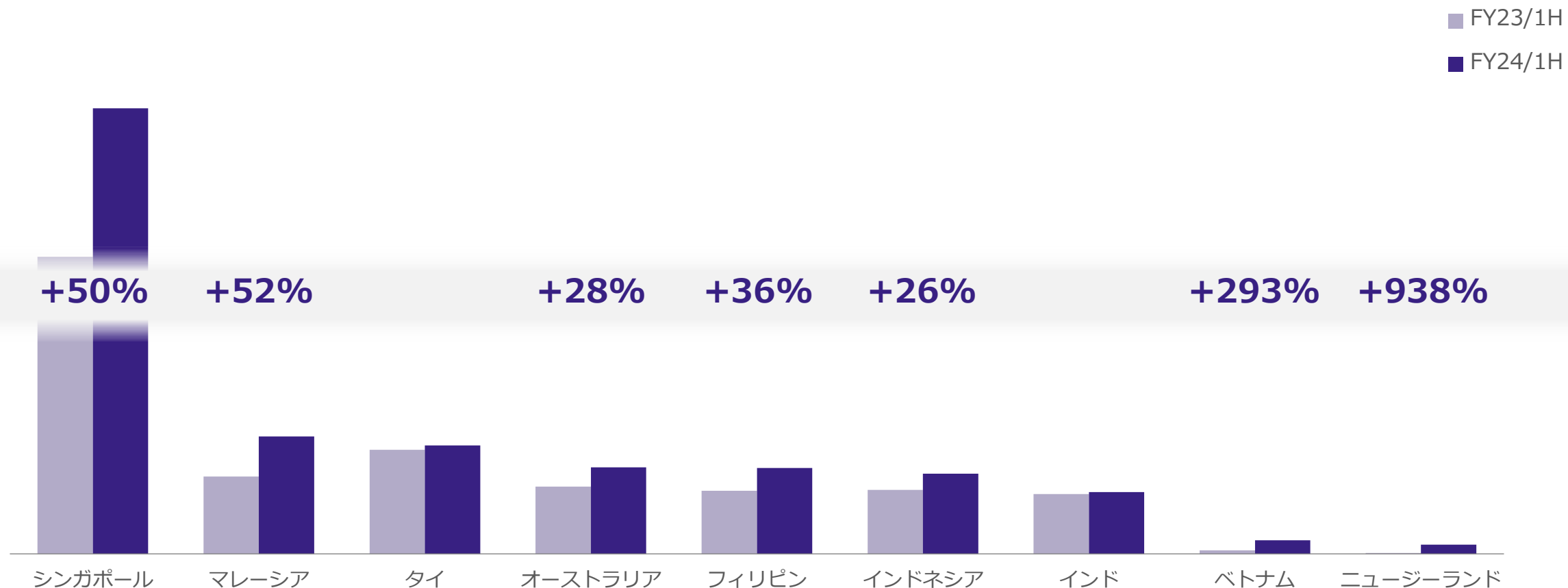
上段：サプライヤ数

下段：売上構成 (FY23)



## 海外ネットワーク事業

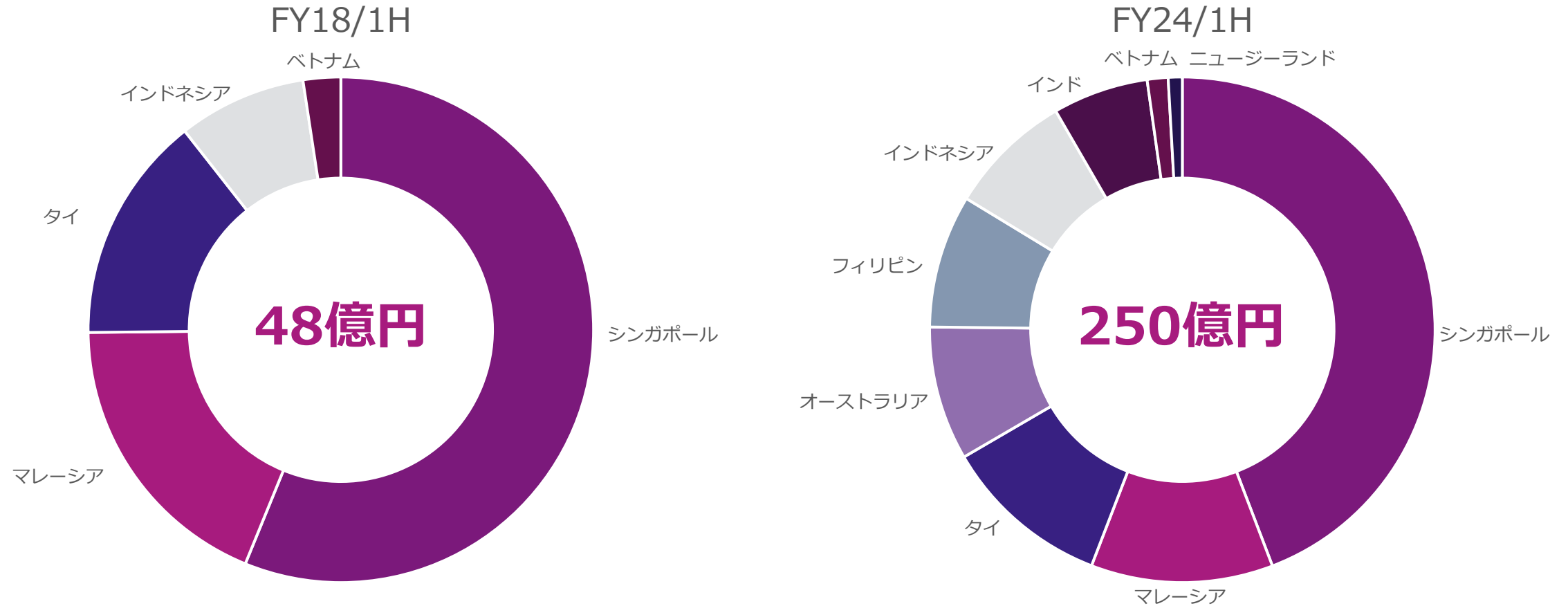
前年同期比67億円増（+37%）、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、フィリピン、インドネシアが伸長



※ %表記は前年同期比。

## 海外ネットワーク事業の売上構成比の変遷

## 売上拡大とともに地域別の構成比が平準化



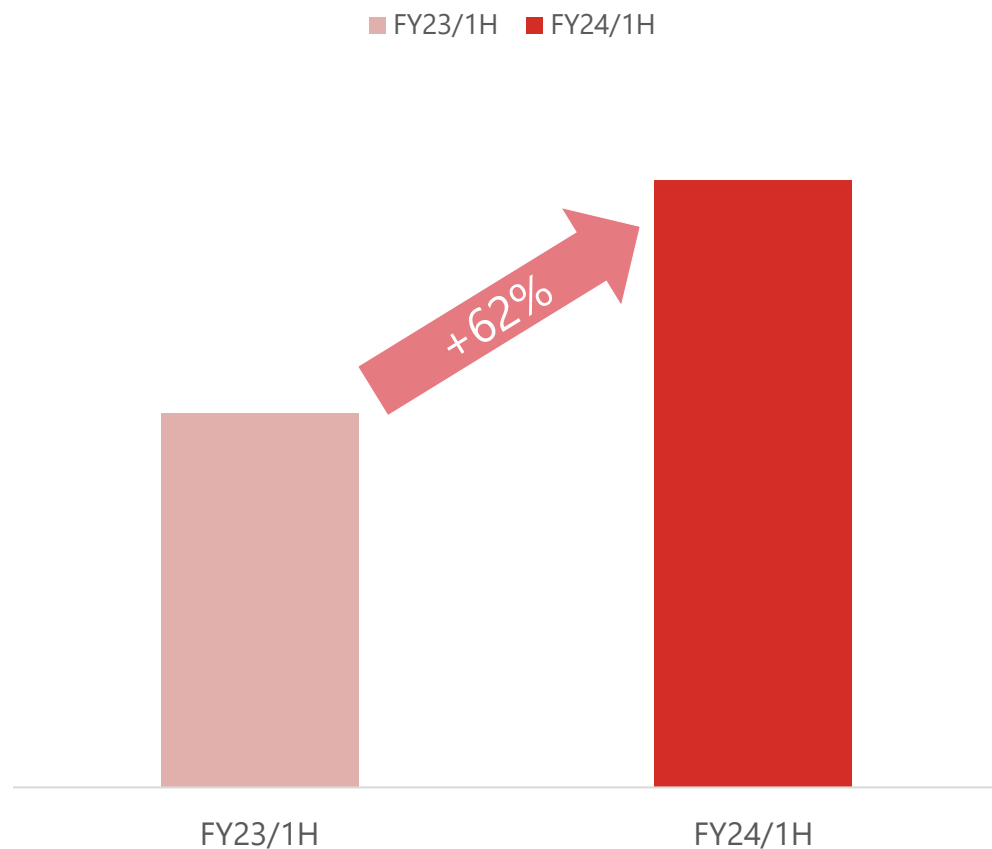
## 02. 中期経営計画 (2022~2024年度)

---

### ④ CPSソリューション事業

## 成長しているCPSソリューション事業

### スマートシティ・モビリティが前年同期比62%成長



### スマートシティ・モビリティ

前年同期比+62%の成長

自社サービス・ソリューション比率：50%

主にFMS（運行管理システム）

定常運行： 6件

実証実験：50件（今年度未見込）



## 自動運転EVバスの国内の広がり

### NTT西日本グループと提携、自動運転EVバスの社会実装を加速



#### Navya Mobilityへの出資

マクニカ	70.85%
NTT西日本	29.15%

#### マクニカ

自動運転EVバスの提供および実装支援  
遠隔モビリティ管理システムの提供および実装支援

#### NTT西日本グループ

自動運転導入エンジニアリングおよびサポート  
都市OS・クラウド・データ連携基盤等のスマートシティサービス  
EV関連ソリューションの提供

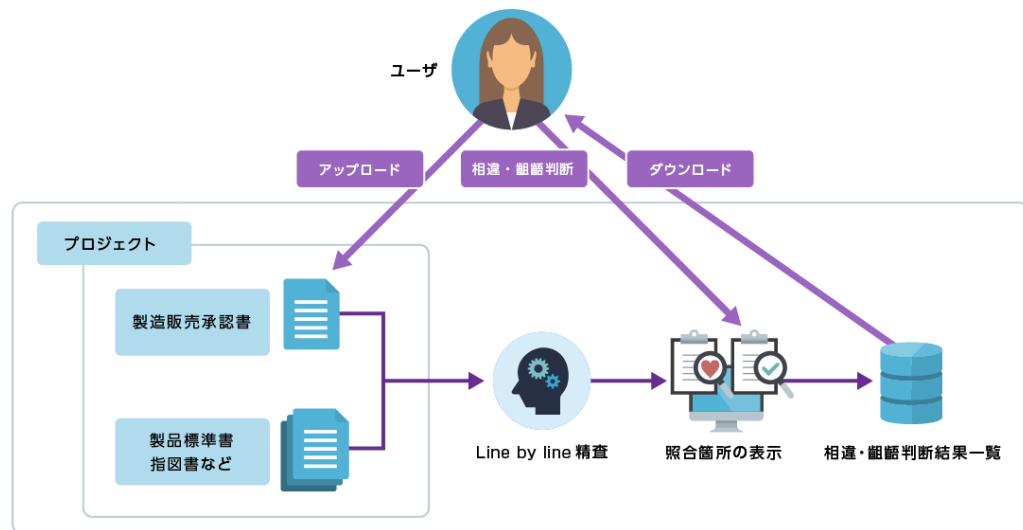
## 新しいソリューションのリリース

### 業界特化型ソリューション

#### 製薬業界向けソリューション

Macnica 製造販売承認書チェッカー

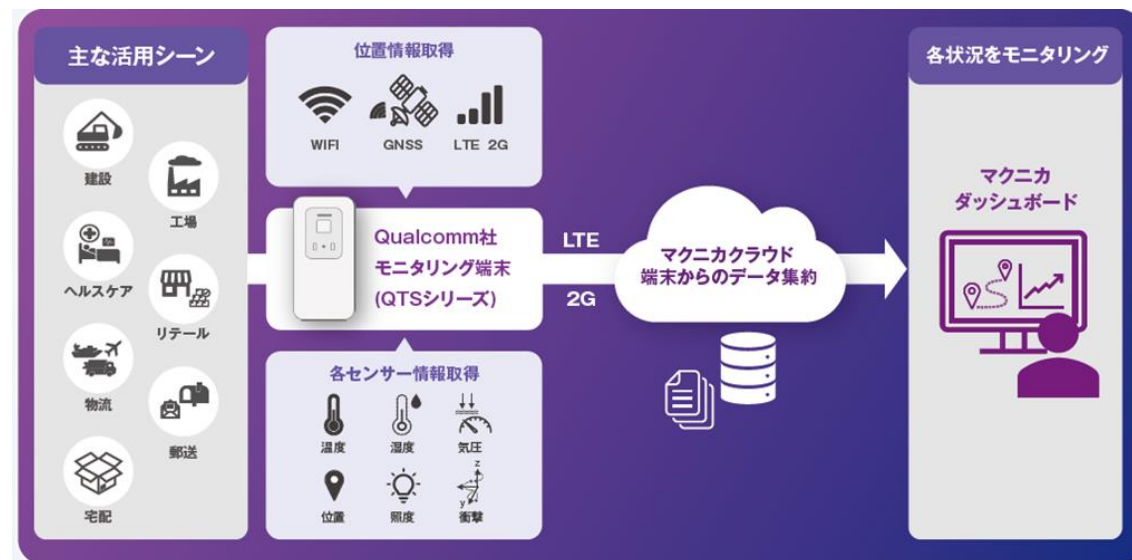
- 背景 厚生労働省が製造販売承認書と製造実態の照合の徹底を要請
- 新事業開発部門で企画、開発。事業部門と共同で営業、広報
- インドの関係会社CrowdANALYTIXが生成AIを活用して開発
- モニターカスタマとの共創により実効性の高いソリューションを開発



#### 物流業界向けソリューション

Macnica Tracks

- 背景① 物流業界の労働力不足
- 背景② コールドチェーン市場の温度管理要求の高度化
- 事業部門が企画。IT部門内のビジネスシステム開発チームが開発
- 位置情報、温湿度、気圧、照度、衝撃検知、紛失/盗難防止、運行状況等を一元管理



## 02. 中期経営計画 (2022~2024年度)

---

### ⑤ 経営基盤強化

## 人的資本の最大化

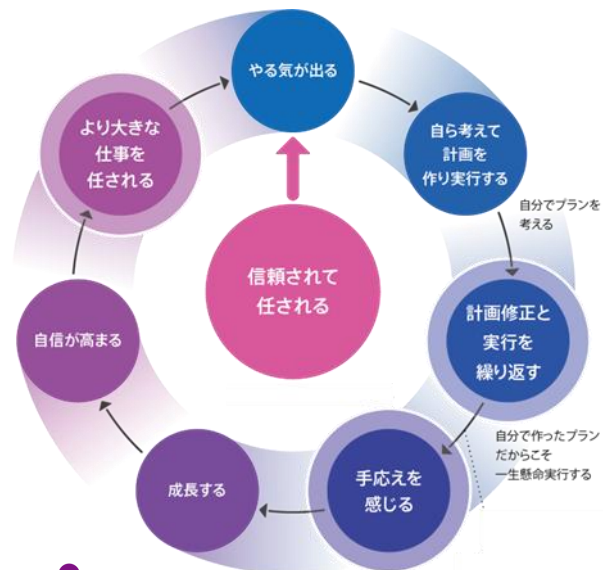
### 独自の人財育成施策



## Career Ownership Management Award 2024

### 最優秀賞 (大企業の部 マネジメントの変革部門)

### 手応えサイクル



### 従業員エンゲージメント

- 経営計画発表会
- Management Message
- 従業員サーベイ
- キャリアフォローアップセミナー
- 社員旅行
- イヤーエンドパーティー

### 新卒社員のオンボーディング

(インタビューツアー)

- 2003年から毎年実施
- 現場の教育担当の発案でスタート
- 「将来の自分像を見つける」
- 平均20人の先輩社員と面談
- 総面談回数1,800回
- うち100回は経営層との面談

## ブランディング強化

### コーポレートブランディングを強化



#### マクニカHDホームページリニューアル テレビCM

パリオリンピック（6回） [\[動画リンク\]](#)

#### サッカーチームスポンサー

横浜FC

川崎フロンターレ

#### 野球場の看板広告

甲子園球場（左中間フェンス）

横浜スタジアム（ベンチ内）

#### 新横浜駅看板

新幹線上りホーム階段

JR横浜線階段（3ヶ所）

駅前ビル屋上看板

## IR活動の強化

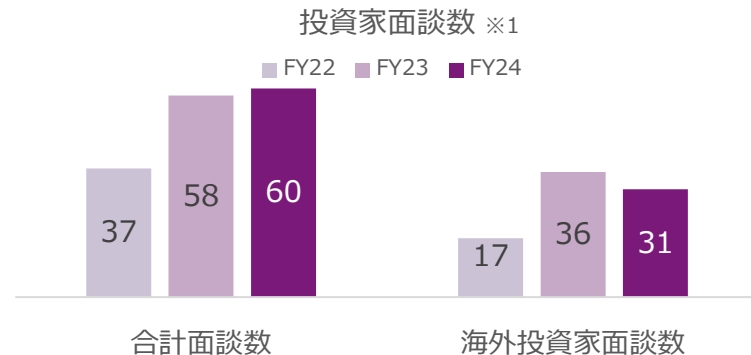
### 初の統合報告書発行・投資家面談の強化

#### 指数への組み込み

JPXプライム150指数  
 JPX日経インデックス400  
 TOPIX 500  
 FTSE All-World Index

#### 機関投資家との面談

新規・海外投資家との面談を強化  
 海外投資家ロードショー



#### ディスクロージャー

[NEW] 統合報告書 “LIMITLESS 2024”を発行

統合報告書 ([リンク](#))

日本語版 発行済

英語版 11月中旬発行 (予定)

統合報告書説明会 ([リンク](#))

[NEW] マクニカHD ホームページのリニューアル

[NEW] スポンサーードリサーチのリニューアル ([リンク](#))

[NEW] 日英同時開示 (決算資料・適時開示)

決算説明会・IRイベントの全文書き起こし (日英) ([リンク](#))

※1 機関投資家バイサイドのみ、第1四半期決算発表後～沈黙期間までに実施した面談を集計

## DXの取り組み

### DXの加速による生産性の向上と商用サービスの強化

コーポレート情報システム

商用情報システム

システム導入

プロセスマイニング

ハイパーオートメーション

ローコード・ノーコード開発システム

ローコード・ノーコード開発基盤

システム基盤

統合データ分析基盤

生成AI活用基盤

IoTプラットフォーム

システム人財

ITプロフェッショナル ・ DXコア人財 ・ デジタル活用人財

## サステナビリティ経営の推進

### サステナブルな成長基盤の継続強化



マルチステークホルダー方針策定	MSCI ESGレーティング BBB	新人事制度	[NEW] DX銘柄2024
DEIステートメント策定	ISO9001 (品質)	グループ全体リスク可視化	[NEW] Career Ownership Management Award 2024 最優秀賞 (大企業の部マネジメントの変革部門)
マクニカグループ人権ポリシー策定	ISO14001	リスク管理規程整備	[NEW] 2024 CRMベストプラクティス賞
健康経営宣言	ISO/IEC 27001	為替リスク最小化	健康経営優良法人2024
パートナーシップ構築宣言	AS9120	EcoVadis利用開始 (人権リスクモニタリング)	
環境VISION、環境方針策定	CDP Bランク	グローバルキャッシュフローマネジメント強化	
機関設計変更	SBT認証		



# MET 2024

Macnica Exponential Technology

ONLINE

12.2<sub>Mon</sub> - 12.13<sub>Fri</sub>

期間中いつでも視聴可能!



入山 章崇氏



大西 可奈子氏



落合 陽一氏  
© Impress Corporation



為末 大氏



黒岩 祐治氏



宮坂 力氏

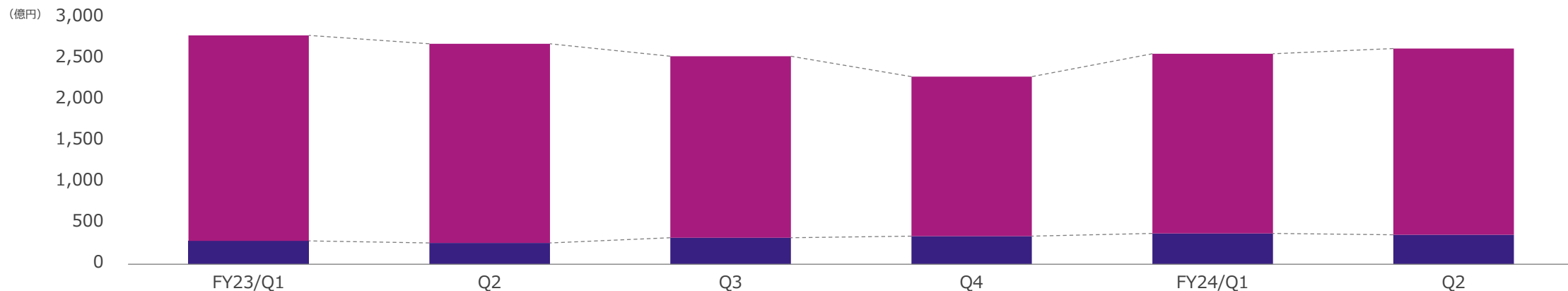


## 03. Appendix

---

### ① 四半期推移

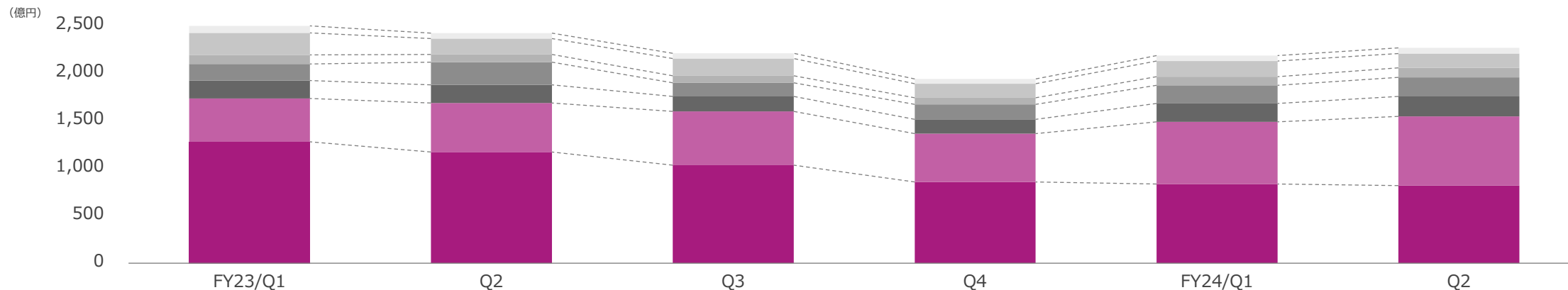
### 四半期推移 セグメント別：売上高



実績 構成比 (億円 %)	セグメント	FY23/Q1		Q2		Q3		Q4		FY24/Q1		Q2	
		売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比
半導体	半導体	2,501	90%	2,424	90%	2,210	87%	1,942	85%	2,187	85%	2,268	86%
	ネットワーク	284	10%	260	10%	323	13%	342	15%	376	15%	358	14%

YoY QoQ	セグメント	FY23/Q1		Q2		Q3		Q4		FY24/Q1		Q2	
		売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比
半導体	半導体	+14%	+8%	+7%	▲3%	▲12%	▲9%	▲16%	▲12%	▲13%	+13%	▲6%	▲4%
	ネットワーク	+29%	▲4%	+7%	▲9%	+32%	+24%	+16%	+6%	+32%	+10%	+38%	▲5%

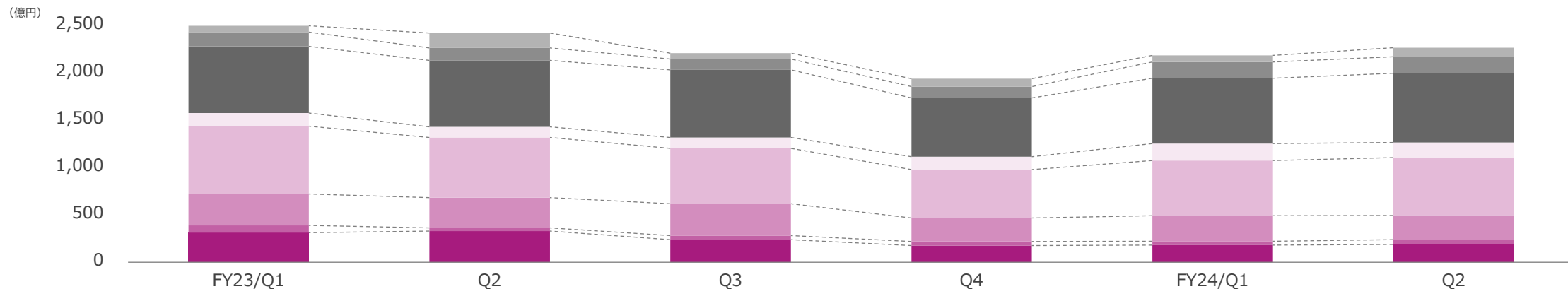
### 四半期推移 半導体事業 (用途別) : 売上高



実績 構成比 (億円 %)	用途	FY23/Q1		Q2		Q3		Q4		FY24/Q1		Q2	
		売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比
実績 構成比 (億円 %)	通信端末	75	3%	59	2%	55	2%	51	2%	56	3%	59	3%
	通信インフラ	232	9%	166	7%	182	8%	147	8%	167	8%	150	7%
	OA・周辺機器	95	4%	81	3%	74	3%	71	4%	89	4%	100	4%
	コンピュータ	175	7%	241	10%	143	6%	156	8%	191	9%	203	8%
	民生機器	189	8%	191	8%	159	7%	152	8%	195	9%	209	9%
	車載	457	18%	516	21%	566	26%	508	26%	656	30%	730	32%
	産業機器	1,278	51%	1,171	48%	1,033	47%	857	44%	834	38%	817	36%
YoY QoQ	通信端末	+12%	+16%	▲14%	▲22%	▲22%	▲7%	▲21%	▲6%	▲25%	+9%	+0%	+5%
	通信インフラ	▲41%	+4%	▲34%	▲29%	▲44%	+10%	▲34%	▲20%	▲28%	+14%	▲9%	▲10%
	OA・周辺機器	+1%	▲1%	▲19%	▲15%	▲32%	▲9%	▲26%	▲4%	▲6%	+26%	+23%	+12%
	コンピュータ	▲12%	+15%	+7%	+38%	▲29%	▲41%	+3%	+9%	+9%	+22%	▲16%	+7%
	民生機器	+19%	+7%	+2%	+2%	▲16%	▲17%	▲13%	▲4%	+3%	+28%	+9%	+7%
	車載	+31%	+7%	+24%	+13%	+19%	+10%	+19%	▲10%	+43%	+29%	+42%	+11%
	産業機器	+37%	+9%	+15%	▲8%	▲9%	▲12%	▲27%	▲17%	▲35%	▲3%	▲30%	▲2%

(株)グローセルは2024年3月末B/S連結、2024年4月よりP/L連結 (半導体事業)

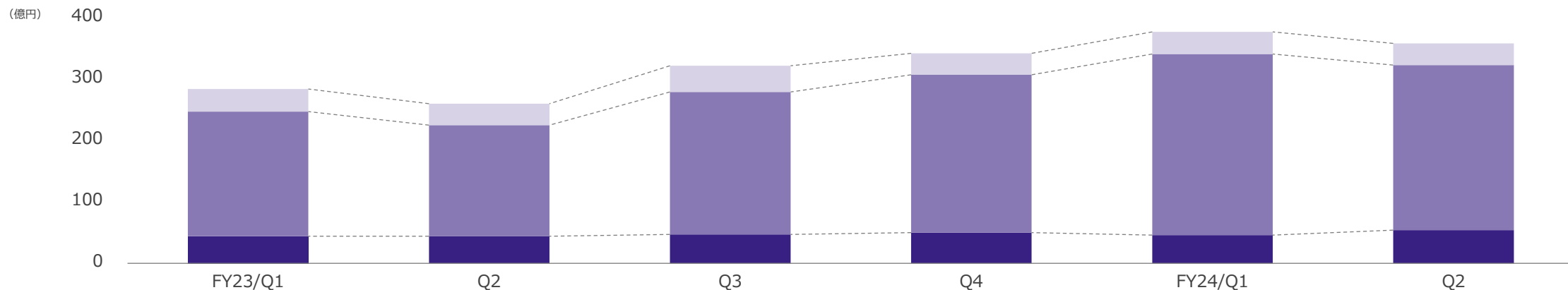
四半期推移 半導体事業 (品目別) : 売上高



		FY23/Q1		Q2		Q3		Q4		FY24/Q1		Q2	
実績 構成比 (億円 %)	その他	67	3%	157	6%	62	3%	85	4%	69	3%	96	4%
	電子デバイス	151	6%	131	5%	115	5%	120	6%	173	8%	173	8%
	その他標準IC	704	28%	703	29%	715	32%	620	32%	689	32%	733	33%
	メモリー	139	6%	113	5%	115	5%	136	7%	181	8%	162	7%
	アナログ	718	29%	636	26%	587	27%	511	26%	583	27%	611	27%
	ASSP	332	13%	320	13%	337	15%	249	13%	269	12%	255	11%
	ASIC	76	3%	35	1%	41	2%	43	2%	41	2%	52	2%
	PLD	313	13%	329	14%	240	11%	176	9%	181	8%	188	8%
YoY QoQ	その他	+67%	+29%	+245%	+134%	+2%	▲61%	+63%	+38%	+3%	▲18%	▲39%	+38%
	電子デバイス	+11%	+17%	▲20%	▲13%	▲27%	▲12%	▲7%	+4%	+14%	+44%	+32%	▲0%
	その他標準IC	+50%	+28%	+35%	▲0%	+25%	+2%	+12%	▲13%	▲2%	+11%	+4%	+6%
	メモリー	▲60%	▲6%	▲55%	▲19%	▲57%	+2%	▲8%	+19%	+30%	+33%	+43%	▲11%
	アナログ	+19%	▲3%	▲7%	▲11%	▲21%	▲8%	▲31%	▲13%	▲19%	+14%	▲4%	+5%
	ASSP	+8%	+1%	▲3%	▲4%	▲6%	+5%	▲24%	▲26%	▲19%	+8%	▲20%	▲5%
	ASIC	+25%	+35%	▲38%	▲54%	▲24%	+15%	▲23%	+7%	▲46%	▲5%	+47%	+26%
	PLD	+38%	+0%	+48%	+5%	▲20%	▲27%	▲44%	▲26%	▲42%	+3%	▲43%	+4%

(株)グローセルは2024年3月末B/S連結、2024年4月よりP/L連結 (半導体事業)

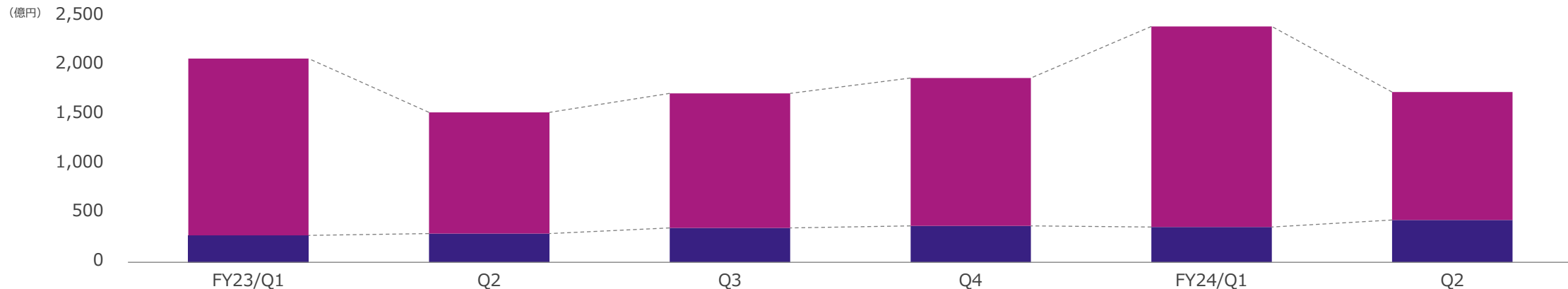
### 四半期推移 ネットワーク事業 (品目別) : 売上高



実績 構成比 (億円 %)	品目	FY23/Q1		Q2		Q3		Q4		FY24/Q1		Q2	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
実績 構成比 (億円 %)	ハードウェア	37	13%	35	13%	43	13%	35	10%	36	9%	35	10%
	ソフトウェア	203	71%	181	70%	232	72%	257	75%	295	78%	269	75%
	サービス	44	15%	44	17%	47	15%	50	15%	46	12%	54	15%

YoY QoQ	品目	FY23/Q1		Q2		Q3		Q4		FY24/Q1		Q2	
		YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ
YoY QoQ	ハードウェア	▲23%	▲5%	▲13%	▲7%	+8%	+22%	▲11%	▲18%	▲5%	+2%	+1%	▲1%
	ソフトウェア	+57%	▲3%	+15%	▲11%	+45%	+28%	+23%	+11%	+45%	+15%	+49%	▲9%
	サービス	+4%	▲7%	▲2%	+0%	+7%	+8%	+7%	+6%	+5%	▲8%	+24%	+18%

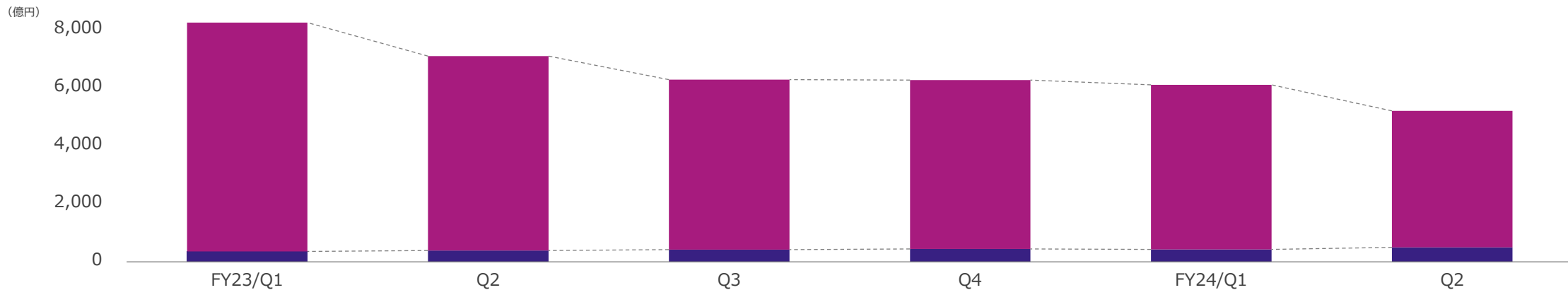
### 四半期推移 セグメント別：受注高



実績 構成比 (億円 %)	Segment	FY23/Q1		Q2		Q3		Q4		FY24/Q1		Q2	
		Value	%	Value	%	Value	%	Value	%	Value	%	Value	%
実績 構成比 (億円 %)	半導体	1,798	87%	1,233	81%	1,368	80%	1,504	80%	2,039	85%	1,301	75%
	ネットワーク	273	13%	291	19%	348	20%	370	20%	357	15%	430	25%

YoY QoQ	Segment	FY23/Q1		Q2		Q3		Q4		FY24/Q1		Q2	
		YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ
YoY QoQ	半導体	▲54%	+69%	▲56%	▲31%	▲31%	+11%	+41%	+10%	+13%	+36%	+6%	▲36%
	ネットワーク	+19%	▲8%	+16%	+6%	+36%	+20%	+24%	+6%	+31%	▲3%	+48%	+20%

### 四半期推移 セグメント別：受注残高



実績 構成比 (億円 %)	セグメント	FY23/Q1		Q2		Q3		Q4		FY24/Q1		Q2	
		金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率
半導体	半導体	7,904	96%	6,713	94%	5,870	93%	5,830	93%	5,683	93%	4,715	90%
	ネットワーク	362	4%	393	6%	419	7%	446	7%	427	7%	499	10%

YoY QoQ	セグメント	FY23/Q1		Q2		Q3		Q4		FY24/Q1		Q2	
		YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ
半導体	半導体	▲20%	▲8%	▲35%	▲15%	▲41%	▲13%	▲32%	▲1%	▲28%	▲3%	▲30%	▲17%
	ネットワーク	+3%	▲3%	+9%	+9%	+13%	+7%	+20%	+7%	+18%	▲4%	+27%	+17%



**MACNICA**